

5G 及び次世代高周波無線通信で使用される 材料・プロセス技術シンポジウム



■日時 2019年12月10日(火) シンポジウム 13:00-17:30
交流会 17:45-19:00

■会場 東京工業大学 蔵前会館ロイヤルブルーホール
(東急目黒線・大井町線 大岡山駅徒歩3分)

■主催 公益社団法人化学工学会 エレクトロニクス部会

■協賛 電子SI連絡協議会(ESIC), 表面技術協会, エレクトロニクス実装学会(JIEP), 日本電子回路工業会(JPCA),
スマートプロセス学会(MSTE), よこはま高度実装技術コンソーシアム(YJC), NPO 法人サーキットネットワーク(C-NET)



■内容

次世代移動通信システムである5Gでは、高速・大容量・低遅延通信を実現するために、サブ6と呼ばれる6GHz以下の周波数帯に加えて、ミリ波と呼ばれる28GHzを超える高周波数帯の利用が進められる。周波数の高い電磁波は直進性が強く、またその伝搬も材料や環境の影響を強く受けることから、高周波に対応した材料やプロセスが求められる。本シンポジウムでは、5Gで広がる市場動向やこれを支える基地局などのハードウェア、ミリ波など高周波を扱うための材料及びプロセス技術について議論を行う。

■プログラム

世界の5G市場最新動向	情報通信総合研究所	岸田 重行
ミリ波応用製品の開発動向と高周波基板への要求条件	富士通株式会社	大橋 洋二
5G及び次世代高周波無線通信に向けた低粗度・高密着性可能な銅箔表面処理技術のご紹介	ナミックス株式会社	佐藤 牧子
高速伝送及び高周波通信用回路基板材料の開発動向	パナソニック株式会社	西野 充修
5G時代の高速・高周波基板の製造及び設計について	沖プリントドサーキット株式会社	飯長 裕

※敬称略

◇オーガナイザ 吉野 雄信(株式会社フジクラ), 薦田 康夫(三井金属鉱業株式会社)

◇更新情報は, <http://www2.scej.org/elebukai/contents/04.html> を参照願います。

■参加費 当日受付にてお支払いください。領収書を用意いたします。

大学関係者(教員, 研究員等)	2,000円
大学関係者(エレクトロニクス部会員), 学生	無料
化学工学会エレクトロニクス部会 個人会員, 部会法人会員各社の社員	3,000円
上記以外の化学工学会会員・化学工学会法人会員各社の社員	6,000円
協賛団体会員	6,000円
一般参加者	10,000円
※エレクトロニクス部会に同時加入いただける方(2020年度分年会費免除)	7,000円

交流会費 3,000円

■申込方法

下記事項を明記の上, メールにてお申し込みください。所定人数(100名)に達したら締め切ります。

メール送付・お問い合わせ先: electro_div@chemeng.osakafu-u.ac.jp

1. 氏名(フリガナ)
2. 勤務先および住所(所属部署まで)
3. メールアドレス,
4. Tel/Fax
5. 懇親会参加の有無
6. 会員資格

※会員資格欄には, 上記参加費欄の区分をご記入ください。協賛団体会員の方は, 団体名も明記ください。